

Doc.No: NR030717

2003年7月17日

半導体製造装置およびFPD機器製造装置に関するサービス事業を再編

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区／社長：石田 明)は、半導体製造装置およびFPD製造装置におけるサービス事業を再編し、本社サービス部門を子会社に統合するとともに、子会社2社の社名および業務内容の変更を実施。8月1日から新体制をスタートさせます。

これは、当社の半導体製造装置、FPD製造装置に関する事業を担当する半導体機器カンパニーおよびFPD機器カンパニーにおいて、生産、販売、保守サービス部門それぞれの独立性を一層明確にすることで、顧客満足度のさらなる向上と充実を目指すもの。これにより、製品の搬入からメンテナンスに至るサービス業務は子会社が全面的に手掛けるとともに、保守部品の調達、販売など業務に付随する事項に関しても子会社で企画、運営していきます。

これに伴い、サービス子会社は、東京を拠点に東日本地区で半導体機器・FPD機器に関するサービスを行っている株式会社ディ・エス・テック東京を株式会社SEBACS(セバックス)に社名変更し、国内全域で半導体製造装置のサポートを専門に行う新体制を確立するとともに、西日本地区を担当エリアとして同様の事業活動を展開している株式会社ディ・エス・テック関西を株式会社FEBACS(フェバックス)に改称し、国内外を対象に事業展開するFPD製造装置専門のサービス会社として再編。地域別のサービス体制からカンパニーに直結した事業領域単位のビジネスへと移行します。両社の新社名はそれぞれ、半導体機器の英語表記の略称SE(=Semiconductor Equipment)、FPD機器の略称FE(=FPD Equipment)にB=Before(納入前)、A=After(納入後)、CS=Customer Support(顧客サポート)を加えて名付けました。

新体制では、従来両社が行ってきた製品の搬入、組み立て、調整作業や修理などに加え、将来的にはメンテナンス契約や装置の機能アップ、他社製品のメンテナンスやモジュール販売、部品販売など、新規事業にも積極的に取り組んでいきます。また、これまで子会社では、ユーザーの依頼を受けた大日本スクリーンから委託を受けてサービス活動を行っていましたが、今後は2社がそれぞれ営業部門を設けてユーザーとの直接取引も進めていくほか、365日24時間体制でのサービスの展開も目指していきます。

<新会社の概要>

●株式会社 SEBACS

(英文表記：SEBACS Co.,Ltd.)

(母体：株式会社ディ・エス・テック東京)

所在地：京都市右京区西京極新明町13-1
 資本金：7,000万円
 代表者：代表取締役社長 高田 剛
 社員数：163名
 目標売上高：初年度18億円、次年度24億円
 事業内容：半導体製造装置に関する搬入・調整・検取作業、修理、改造、部品修理・販売、メンテナンスなど保守サービス事業

新体制スタート：2003年8月1日

●株式会社 FEBACS

(英文表記：FEBACS Co.,Ltd.)

(母体：株式会社ディ・エス・テック関西)

所在地：京都市北区紫野西御所田町68番地 第二サンシャインビル3F
 資本金：5,000万円
 代表者：代表取締役社長 梅本 長美
 社員数：63名
 目標売上高：初年度20億円、次年度30億円
 事業内容：FPD機器製造装置に関する搬入・調整・検取作業、修理、改造、部品修理・販売、メンテナンスなど保守サービス事業

新体制スタート：2003年8月1日

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀南通寺之内上ル4丁目